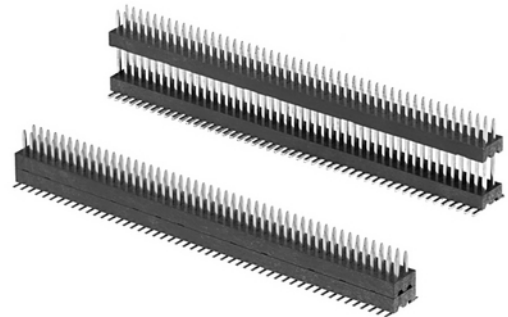


## SMT-Sandwich-Stiftleisten RM 0,80x1,20mm, 2-reihig SMT Dual Body Pin Headers, 0.80x1.20mm Pitch, Double Row

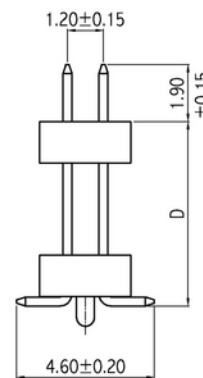
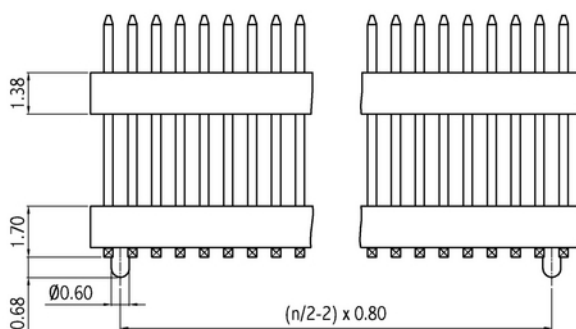
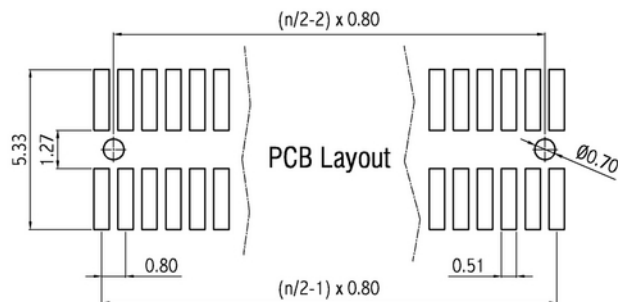
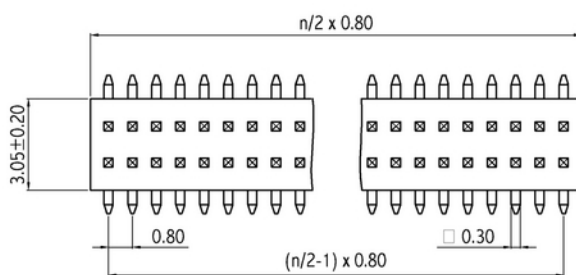
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,30mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.30mm square pin, copper alloy
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-65°C ... +125°C
Temperature Range	-65°C ... +125°C
Verarbeitung	260°C max. für 6s
Processing	260°C max. for 6s



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Mate with Female Headers:  
**7850**



Series	Contacts*	Plating*	Locating Pegs*	Height*	Packaging*
<b>7069</b>	<b>040</b> 006-100	<b>00</b> 00 Vergoldet Gold plated 10 Au 0,25µm Au 0.25µm	<b>10</b> 00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen With loc. pegs	<b>2</b> 1 D=3.20mm 2 D=6.15mm	<b>PPST</b> ST PPST PPTR

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pad / In tubes with P&P-Pad  
**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pad / Tape & Reel with P&P-Pad

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
 FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
 WEBSITE www.wpro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

